

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



DEV-KIT ME-IO: zawiera 1 x obudowa ME-IO 18,8 i wtykowa technika podłączeniowa (HSCH z HSCP), dostarczane w pojedynczych częściach

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
- Zasada Lock and Release do automatycznego zatrasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
- Wtykowe przyłącza czołowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2202527
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBD
Klucz produktu	ACHEBD
GTIN	4055626141770
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

2202527

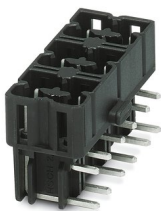
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>

Zestaw składa się z

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201788>

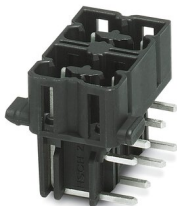


Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>

HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2201780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201780>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201799>



Obudowa na szynę DIN, 2U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>



HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201795>



Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 109,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>

Dane techniczne

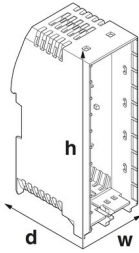
Wskazówki

Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Maks. liczba pinów	28 (raster: 5 mm)
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze stykiem uziemienia funkcyjnego, z systemem 7U Lock and Release
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ME-IO

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,9 mm
Wysokość	113,3 mm
Głębokość	76,5 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	70 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>

Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %
---	------

Dane PCB

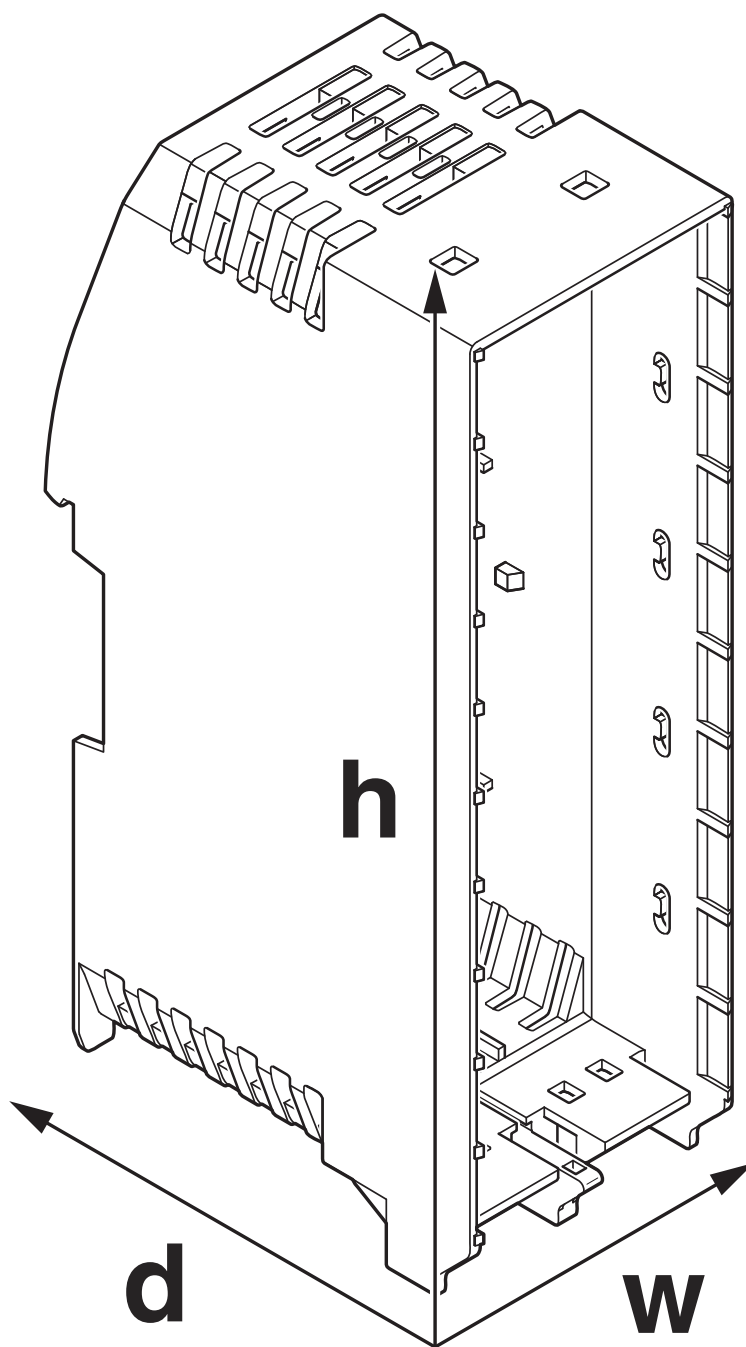
Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME-IO 18,8 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202527>

Akcesoria

ME-IO 18,8/28 TBUS DEV-PCB - Płytki druk.

2202548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202548>

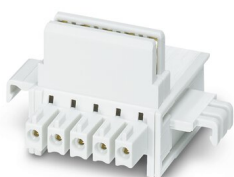
Płytki z rastrem perforowanym do ME-IO 18,8 DEV-KIT; do listwy podstawowej HSCH 2,5; nadaje się do ręcznego lutowania



ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Konektor na szynę nośną

2202549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202549>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl